
南亞電路板股份有限公司 2019年營運概況

2020年3月25日



免責聲明

歷史事件的陳述可能包括未經會計師審閱之資訊，其可能有某些不足或缺陷而無法忠實呈現目前南亞電路板股份有限公司之財務狀況或營運結果。

本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與本會明示或暗示的預估有所差異。其原因可能來自於各種因素，包括但不限於市場需求、價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、供應鏈、匯率波動以及其他本公司所不能掌控的風險等因素。

除主管機關要求公開之資訊外，本公司並無義務揭露或更新對未來產品方面之意見與看法。



議程

- 公司概況
- 財務狀況
- 產品未來發展方向
- 未來營運目標



公司概況

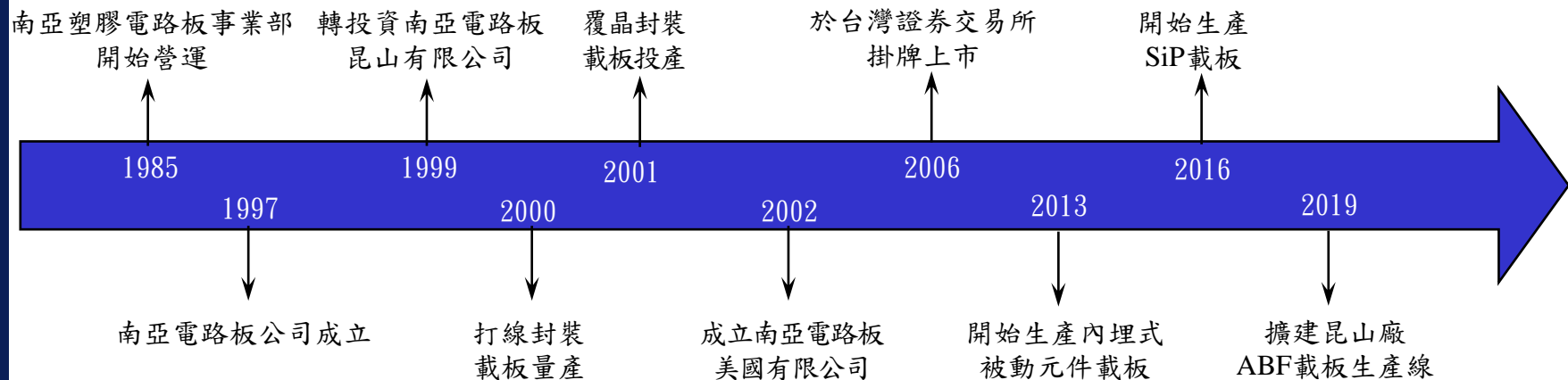
事業簡述

- 南亞塑膠工業股份有限公司之轉投資公司
- 生產與銷售一般電路板與IC載板
- 2019年合併營業額為新台幣 310.9億元。
- 台股上市市值：新台幣296.9億元(2019年12月31日)
- 生產廠區：台灣、大陸



公司概況

歷史沿革



- 1985 : 南亞塑膠公司電路板事業部成立並開始生產一般電路板
- 1997 : 經南亞塑膠董事會通過，以轉投資方式成立南亞電路板公司
- 1999 : 轉投資南亞電路板(昆山)有限公司，註冊資本額2,980萬美元
- 2000 : 進入IC載板領域並量產打線封裝載板
- 2001 : 進行技術升級，開始投產覆晶封裝載板
- 2002 : 成立南亞電路板(美國)有限公司
- 2006 : 正式於台灣證券交易所掛牌上市，交易代號為8046
- 2013 : 產品技術升級，開始生產內埋式被動元件載板
- 2016 : 開始生產系統級封裝載板(System in Package, SiP)
- 2019 : 因應市場需求，開始於昆山廠擴建ABF載板生產線



財務狀況

近三年合併營業收入(IFRS)

(新台幣百萬元)

營業額

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

年成長率：+8.3%

年成長率：+7.8%

26,623.0

28,832.6

31,094.0

2017年

2018年

2019年

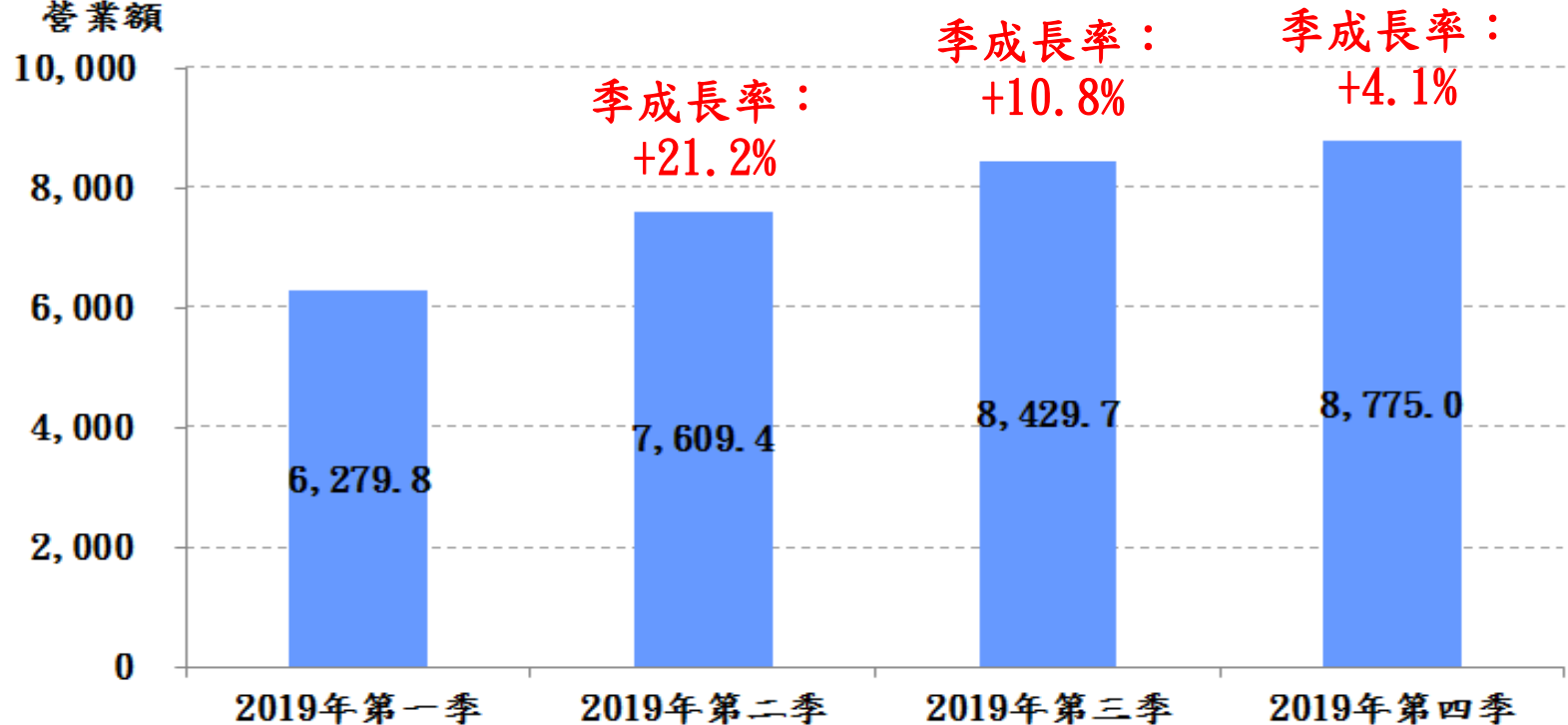
- 2018營收較2017年增加8.3%:
本公司致力於拓展高值化產品市場，提升產品平均售價，故2018年營收比2017年成長。
- 2019營收較2018年增加7.8%:
本公司持續提升高值化產品比重，產品平均單價續揚，使2019年營收比2018年成長。



財務狀況

2019年每季合併營業收入(IFRS)

(新台幣百萬元)
營業額



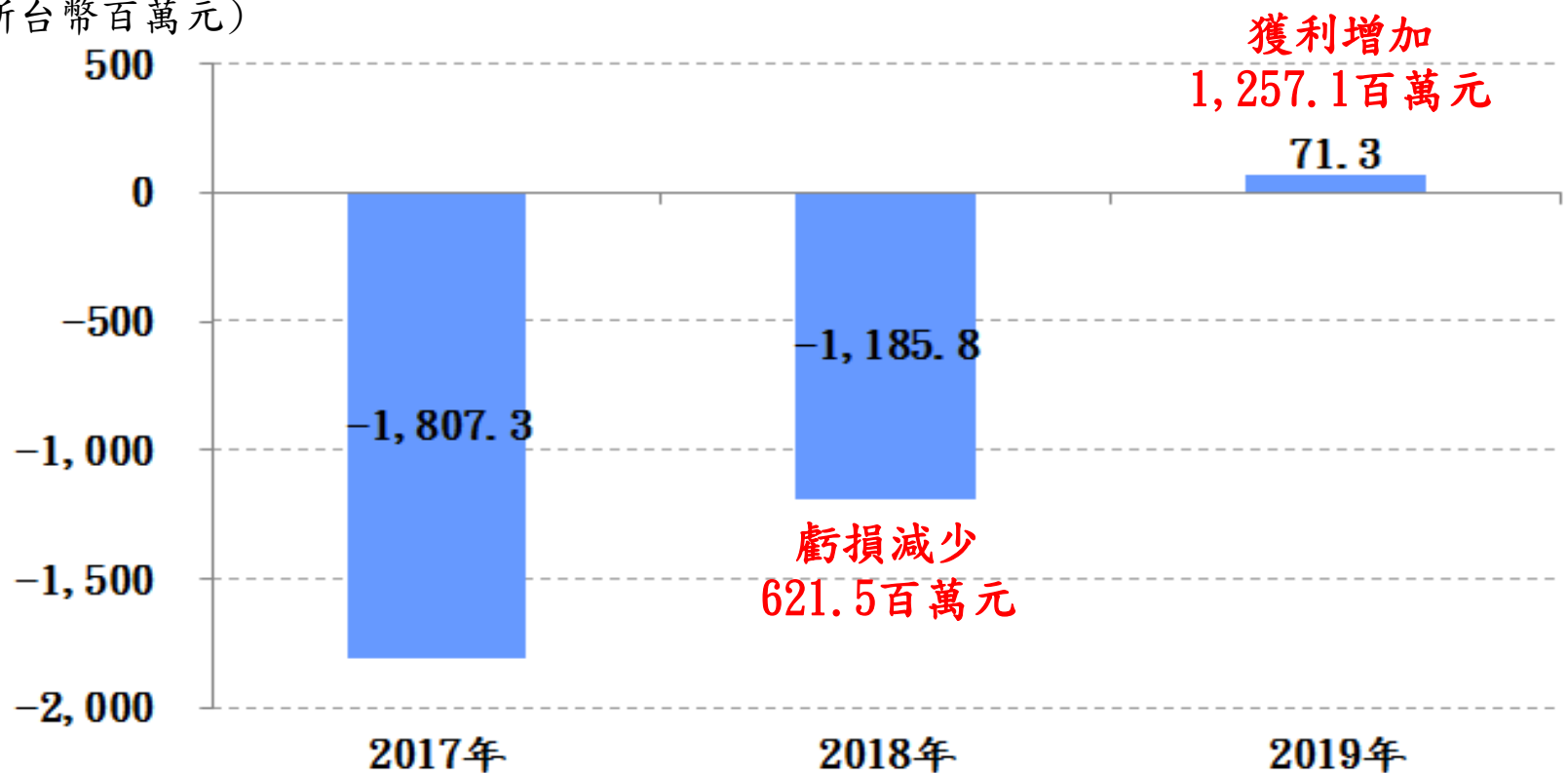
- 2019年第二季營收較第一季增加21.2%：
2019年第二季逐漸擺脫電子產品銷售淡季影響，營收比第一季成長。
- 2019年第三季營收較第二季增加10.8%：
2019年第三季因系統級封裝(SiP)與中介板需求提升，故第三季營收持續成長。
- 2019年第四季營收較第三季增加4.1%：
2019年第四季因ABF載板銷售狀況持續增溫，故第四季營收進一步成長。



財務狀況

近三年營業利益(虧損)

(新台幣百萬元)



■ 2018年營業虧損較2017年減少621.5百萬元：

本公司2018年致力於提升高值化產品銷售比重，改善產品組合，使2018年營業虧損比2017年減少。

■ 2019年營業利益較2018年增加1,257.1百萬元：

本公司2019年高層數大尺寸網通載板等高值化產品銷售佔比持續提升，使2019年營業利益成功轉盈。

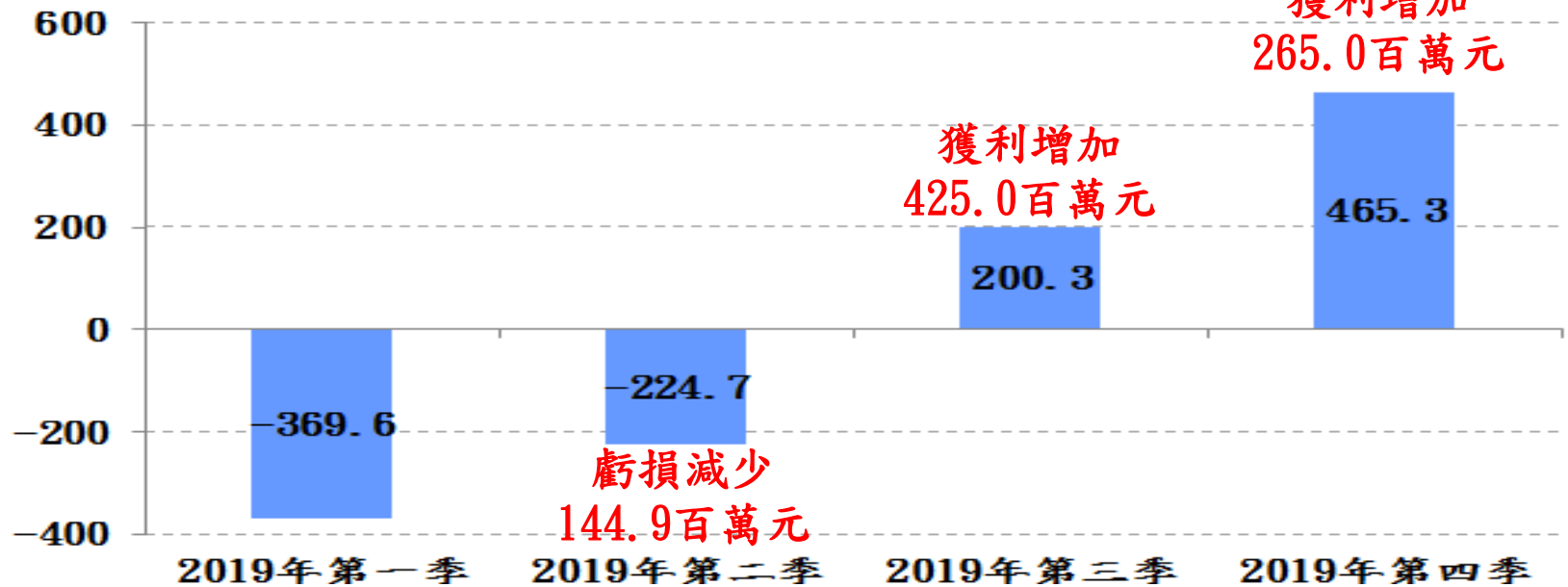


財務狀況

2019年每季營業利益(虧損)

(新台幣百萬元)

營業利益

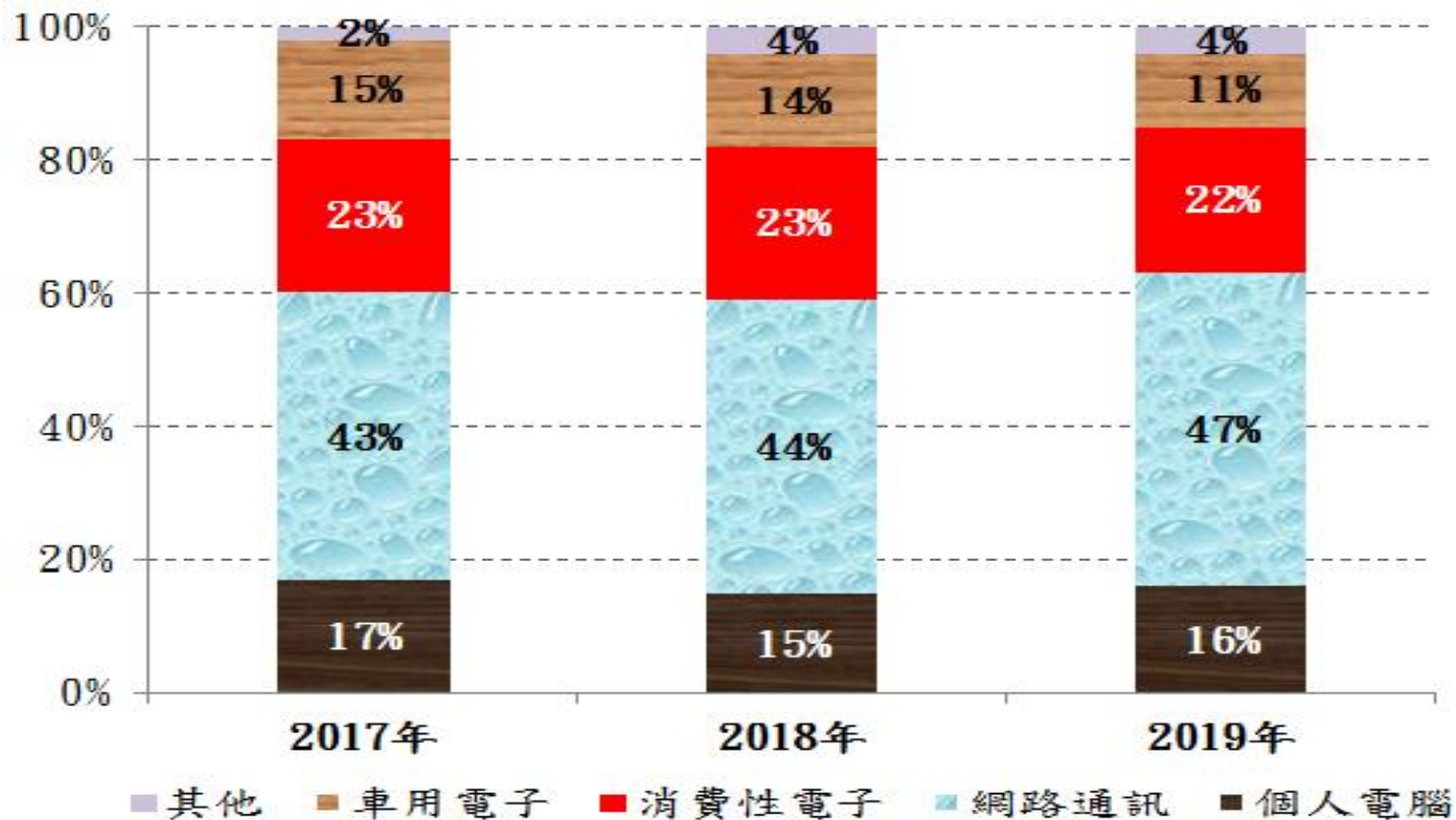


- 2019年第二季營業虧損較第一季減少144.9百萬元：
因脫離傳統銷售淡季，產品需求回溫，故第二季虧損比第一季減少。
- 2019年第三季營業利益較第二季增加425.0百萬元：
因高層數大尺寸網通載板、SiP載板及中介板等High Value產品銷售增加，故第三季獲利比第二季提升。
- 2019年第四季營業利益較第三季增加265.0百萬元：
因高層數大尺寸網通載板需求續旺，故第四季獲利比第三季提升。



財務狀況

營業收入結構(應用別)

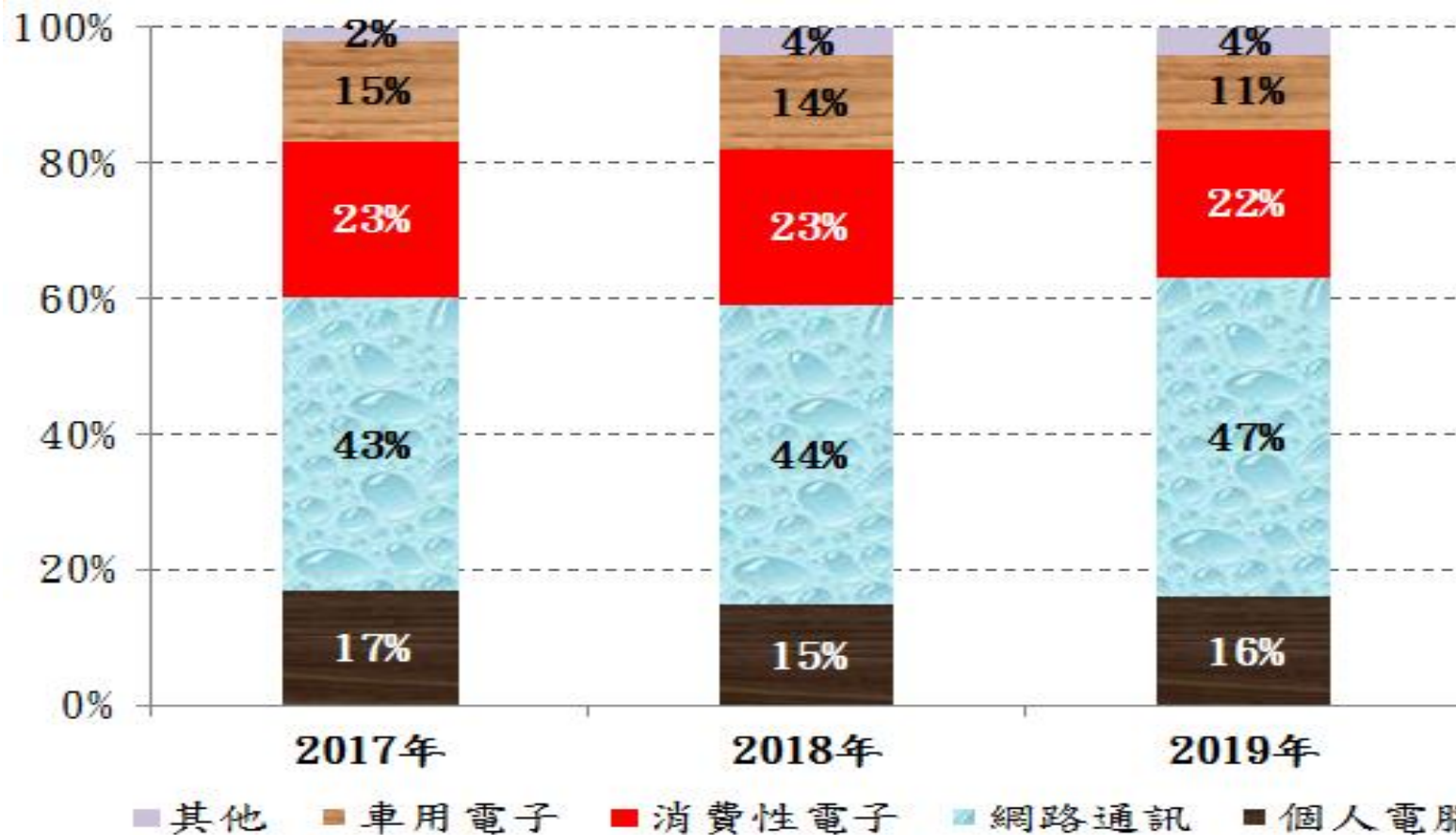


- 本公司受益於處理器客戶市占率提高與提早布局高階網通設備市場，2019年個人電腦與網通產品營收占比提高。
- 受到遊戲機進入產品生命週期尾聲，且穿戴式裝置客戶於上半年調整庫存影響，本公司2019年消費性電子產品營收占比略為下滑。



財務狀況

營業收入結構(應用別)



- 因中美貿易問題導致全球景氣低迷，終端汽車市場銷售疲弱，影響車用電子需求，故2019年車用電路板營收占比下滑。
- 本公司持續開發人工智慧與高效運算等產品，抵銷加密貨幣應用產品需求減少之影響，2019年其他類營收占比與2018年持平。



產品未來發展方向

持續拓展高值化產品

■ 高階ABF載板

2020年除持續配合客戶，量產高層數大尺寸之5G網通設備、伺服器、7奈米電腦與遊戲機處理器等載板外，亦生產AR/VR與人工智慧/高效運算晶片等線路設計複雜、技術層次較高之載板，可有效提升產品平均售價。

■ SiP載板

因應電子產品輕、薄、短、小的發展趨勢，封裝技術發展由IC單一晶片封裝，演變為IC異質晶片封裝，系統級封裝(SiP)載板除應用於穿戴式裝置外，未來行動裝置相機模組與5G手機天線模組(AiP)亦將採用，SiP載板需求可望大幅增加。

■ 高密度連接板(HDI)

伴隨行動裝置、消費性電子及車用電子等產品設計愈趨精密，高平均單價之HDI使用量持續增加，本公司今年將配合終端市場發展，陸續推出高階筆電與伺服器主機板、自動駕駛控制模組等產品，以提高獲利。



未來營運目標

公司追求營業利益持續獲利

■ 2020年上半年獲利可望年成長

上半年電子產品銷售受傳統淡季影響，但本公司除持續提升技術能力與生產效率外，亦推動產能去瓶頸與製程優化等專案，並因高層數大尺寸網通載板需求續旺，故預期2020年上半年獲利表現可望比2019年同期成長。

■ 2020年追求本業每季獲利

開源：本公司除延續2019年策略，持續開發高階網通設備、人工智慧/高效運算及系統級封裝等高值化產品外，亦針對高階IC載板擴充產能，以提高產品市占率，並提振公司營運績效。

節流：本公司將持續推動製程優化與改善生產流程，以提升產品良率與生產效率，並透過各項成本控管改善專案，強化營運績效，2020年將以本業每季獲利為努力目標。



感謝您的聆聽

